



"Технологии монтажа компонентов"

Программа семинара рассчитана на конструкторов-разработчиков электронной техники и нацелена на ознакомление с современными методами монтажа компонентов, а также освещение проблем, возникающих при монтаже и способы их решения.

Участие в семинаре бесплатное.

Семинар состоится 15 мая 2009 г. в 10.00.

9.20-10.00	Сбор и регистрация участников семинара.
10.00-11.00	Ковалевский Ю.С. "Стандарт IPC-A-610D «Критерии приемки электронных сборок»"
11.10-12.20	Новиков С.Н. ЗАО Предприятие "Остек". "Технологии контроля за качеством пайки - виды оборудования, примеры дефектов и способы их устранения с рассмотрением тем: критерии качества пайки, виды контроля, дефекты, их причины и способы устранения".
12.20-13.15	Обед
13.15-14.15	Петров С.Н. ООО "РТС-Инжиниринг" "Бездефектная сборка электронных изделий: необходимость внедрения контрольных операций, методы контроля технологических этапов сборочного процесса, типы обнаруживаемых дефектов на контрольных операциях".
14.25-15.25	Смирнов Л.В. ООО "ДИАЛ-ЭЛЕКТРОЛЮКС" "Технологическое оборудование для нанесения паяльной пасты"
15.35-16.35	Курносенко А.Е. ЦТИ ПЭ «Пайка в паровой фазе: тенденции применения, режимы и конфигурации оборудования»

Регистрация для участников семинара открыта с 28 апреля по 14 мая 2009 г. на сайте АПЭАП по ссылке <http://apeap.ru/open>

Место проведения семинара: г. Москва, Берниковская наб., д. 14
МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского, 5 этаж, актовый зал. Вход по спискам.
Проезд: от станции метро "Таганская (кольцевая)" пешком по ул. Земляной Вал до Берниковской набережной;
от станции метро "Курская" троллейбусом №10, Б;
от станции метро "Китай-город" троллейбусом №45, 63.

Следующий бесплатный семинар на тему **"Микроконтроллеры"** состоится 19 июня 2009 года. Заявки на выступление с докладом и участие в качестве слушателя принимаются по адресу: open@apeap.ru